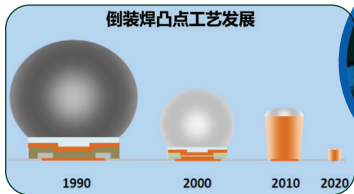


# 极低残留免洗 倒装焊助焊剂

倒装焊凸点工艺发展



- 适用于铜柱或其它凸点
- 兼容多种底部填充材料
- 无分层或对机械可靠性造成影响
- 适用于无铅合金
- 回流后残留极低
- 无卤
- 免洗

[china@indium.com](mailto:china@indium.com)  
[www.indium.com](http://www.indium.com)



所有钢泰公司的焊锡膏和焊片工厂均  
获得了 IATF 16949:2016 认证  
钢泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公

©2024 钢泰公司 表格编号: 99580 (SC) R1

**INDIUM**  
CORPORATION®  
钢泰公司

# 极低残留免洗 倒装焊助焊剂

	NC-699	NC-26-A	NC-26S	NC-809 ★ 同类最佳	一般免洗助焊剂
回流后残留物比重典型值 (TGA 数据)	<2%	~5%	<10%	<7%	40-60%
可焊性					
残留物级别					
底部填充工艺(CUF/MUF)适用性					
底部填充材料(CUF/MUF)兼容性					
回流过程中粘住大芯片的能力					
典型应用	存储芯片封装	逻辑芯片封装	逻辑体	逻辑体	

## 主要应用领域

- 加密货币矿机专用芯片
- 存储芯片
- SAW 滤波器
- 功率芯片

china@indium.com  
www.indium.com



所有钢泰公司的焊锡膏和焊片工厂均  
获得了 IATF 16949:2016 认证  
钢泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公

©2024 钢泰公司 表格编号: 99580 (SC) R1

INDIUM  
CORPORATION®  
钢泰公司